



中华人民共和国国家标准

GB/T 17572—1998
idt IEC 748-2-4:1992
QC 790104

半导体器件 集成电路 第2部分:数字集成电路 第四篇 CMOS 数字集成电路 4 000B 和 4 000UB 系列族规范

Semiconductor devices—Integrated circuits
Part 2: Digital integrated circuits
Section four—Family specification for complementary MOS
digital integrated circuits, series 4 000B and 4 000UB

1998-11-17 发布

1999-06-01 实施

国家质量技术监督局 发布

前 言

本标准等同采用国际电工委员会(IEC)标准 IEC 748-2-4:1992《半导体器件集成电路 第2部分 数字集成电路 第四篇—CMOS 数字集成电路 4 000B 和 4 000UB 系列族规范》。

本标准与《CMOS 数字集成电路 4 000B 和 4 000UB 系列空白详细规范》一起,可作为编制 CMOS 数字集成电路 4 000 系列电路详细规范的依据。

本标准引用的国家标准 GB/T 4937—1995 和 GB/T 9424—1998 分别等同采用 IEC 749:1984 及修改单 1(1991)和 IEC 748-2-5:1992。

本标准第 8 章表 I 中的分组形式作了技术处理,以便与 IEC 748-11(1990)相一致,10.3 中的曲线也作了更正。

本标准由中华人民共和国电子工业部提出。

本标准由全国集成电路标准化分技术委员会归口。

本标准起草单位:电子工业部标准化研究所、西安微电子技术研究所。

本标准主要起草人:陈裕焜、陈学礼。

IEC 前言

1) IEC(国际电工委员会)在技术问题上的正式决议或协议,是由对这些问题特别关切的国家委员会参加的技术委员会制定的,对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见。

2) 这些决议或协议,以推荐标准的形式供国际上使用,并在此意义上为各国家委员会所认可。

3) 为了促进国际上的统一,IEC 希望各国家委员会在本国条件许可的情况下,采用 IEC 标准的文本作为其国家标准。IEC 标准与相应国家标准之间的差异,应尽可能在国家标准中指明。

本标准是由 SC47A(集成电路)和 IEC TC47(半导体器件)制定的。

本标准系 CMOS 数字集成电路 4 000B 和 4 000UB 系列族规范。

本标准文本以下列文件为依据:

六个月法	表决报告
47A(CO)174	47(CO)194
47(CO)1050	

本标准表决批准的详细资料可在上表列出的表决报告中查阅。

本标准封面的 QC 编号是 IEC 电子元器件质量评定体系(IECQ)规范号。

本标准引用下列 IEC 标准:

747-1:1983 半导体器件 分立器件 第 1 部分 总则

修改单 1(1991)

747-10:1991 半导体器件 分立器件 第 10 部分 分立器件和集成电路总规范

748-2:1985 半导体器件 集成电路 第 2 部分 数字集成电路

修改单 1(1991)

748-11:1990 半导体器件 集成电路 第 11 部分 半导体集成电路(不包括混合电路)分规范

749:1984 半导体器件 机械和气候试验方法

修改单 1(1991)

中华人民共和国国家标准

半导体器件 集成电路

第2部分:数字集成电路

第四篇 CMOS 数字集成电路

4 000B 和 4 000UB 系列族规范

GB/T 17572—1998
idt IEC 748-2-4:1992
QC790 104

Semiconductor devices—Integrated circuits

Part 2: Digital integrated circuits

Section four—Family specification for complementary MOS

digital integrated circuits, series 4 000B and 4 000UB

引言

IEC 电子元器件质量评定体系遵循 IEC 章程并在 IEC 授权下工作。该体系的目的是确定质量评定程序,以这种方式使一个参加国按有关规范要求放行的电子元器件无需进一步试验而为其他所有参加国同样接受。

本族规范是半导体器件的一系列空白详细规范之一,并应与下列 IEC 标准一起使用。

747-10/QC700 000 半导体器件 分立器件 第10部分 分立器件和集成电路总规范

748-11/QC 790 100 半导体器件 集成电路 第11部分 半导体集成电路(不包括混合电路)分规范

要求的资料

本页及下面方括号内的数字与下列各项要求的资料相对应,这些资料应填入相应栏中。

详细规范的识别

[1] 授权发布详细规范的国家标准化机构名称。

[2] 详细规范的 IECQ 编号。

[3] 总规范、分规范的编号及版本号。

[4] 详细规范的国家编号、发布日期及国家标准体系要求的任何资料。

器件的识别

[5] 主要功能和型号。

[6] 典型结构(材料、主要工艺)和封装资料。

如果器件具有若干种派生产品,则应指出其差异,例如,在对照表中列出特性差异。

如果器件属静电敏感型,在详细规范中应附加预防说明。

[7] 外形图、引出端识别、标志和/或与外形有关的参考文件。

[8] 按总规范 2.6 的质量评定类别。

[9] 参考数据。

[本规范下面方括号给出的条款构成了详细规范的首页,那些条款仅供指导详细规范的编写,而不
应纳入详细规范中]